第10章

半导体存储器及可编程逻辑器件 Memory and Programmable Logic Device

§ 10.1 半导体存储器概述

半导体存储器是存储信息的器件,由许多存储单元组成。

每个存储单元都有唯一的地址代码,能存储一位(或一组)二进制信息,可以由触发器或电容构成。

10.1.1 半导体存储器分类

```
接存取
方式 { SAM (Sequential Access Memory, 顺序存储器)
RAM (Random Access Memory, 随机存储器)
ROM (Read Only Memory, 只读存储器)
```

10.1.2 存储器的技术参数

存储周期

存储器的性能基本上取决于从存储器读出信息和把信息写入存储器的速率。

把连续两次读(写)操作间隔的最短时间称为存取周期。存取周期越短越好.

存储容量

(1) 存储单元:

存储一位信息的单元

(2) 二进制数据单位

Bits

Bytes

Words

Bit (位)是二进制最小单元.

Byte (字节) 缩写 B, 1 Byte = 8 bits

Word (存储字)

一组存储单元,表示某种类型的数据或信息

 $2^{10} = 1024 \approx 1 \text{k}$; $2^{20} \approx 1 \text{M}$; $2^{30} \approx 1 \text{G}$.

字长 n位 8位/字, 16位/字, 32位/字

(3) 容量: 存储单元总数 字数×位数

常用多少字节表示容量: 32k bits 或 4k bytes

§ 10.2 随机存储器 RAM

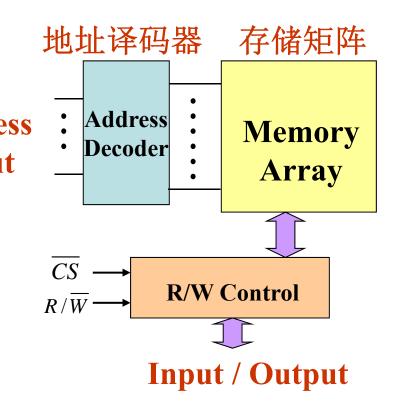
优点: 所有 RAM 具有读、写功能。

缺点: RAM属于挥发性元件, 断电将丢失全部数据

10.2.1 RAM 基本结构

有储矩阵 地址译码器 Input 输入/输出控制

{ Chip Select 片选 Read/Write 读/写



1. 存储矩阵

RAM的主要部分

1024 个字排成 32×32 的矩阵

编号:

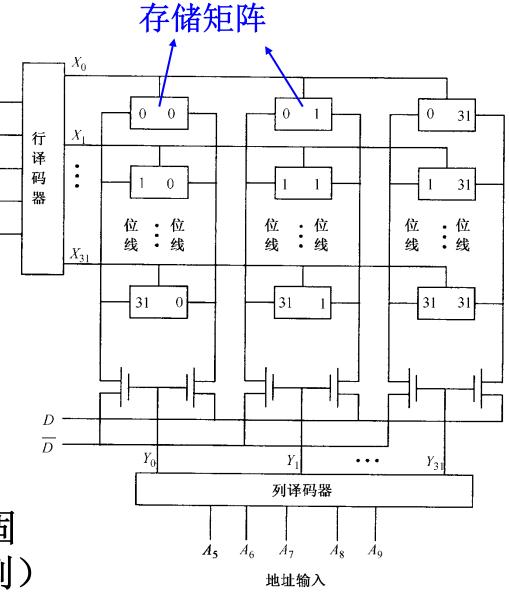
32行编号为

 $X_0, X_1, ..., X_{31}$

32列编号为

 $Y_0, Y_1, ..., Y_{31}$

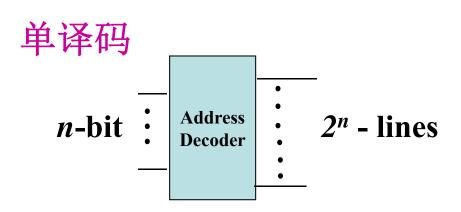
每个存储单元都有固定的编号 $(X_i$ 行、 Y_j 列)即地址 Address



1k×1位存储矩阵及地址译码器

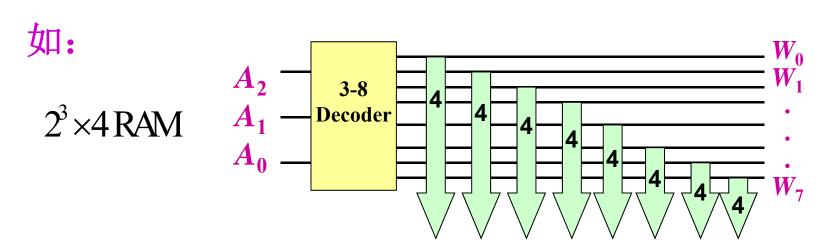
2. 地址译码器

∫単译码 双译码



双译码

将地址所对应的 二进制数译成:行 选信号和列选信号, 从而选中该存储单 元。



1024 字: 210

字线 (地址线): 10条

地址译码器 双译码结构:

行地址译码器:

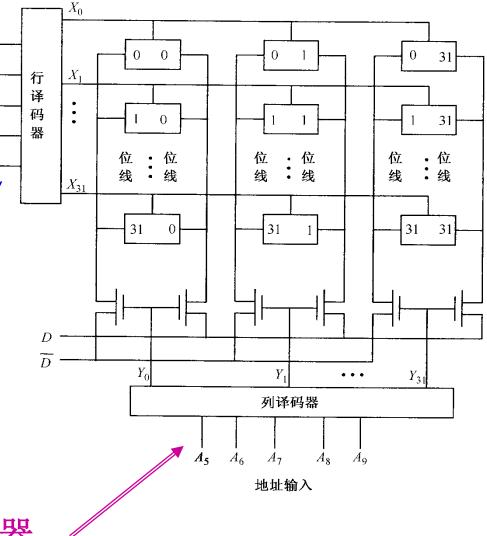
5-32 译码器

输入: A_0 、 A_1 、...、 A_4

输出: X_0 、 X_1 、...、 X_{31} ;

列地址译码器: 5-32 译码器

输入: A_5 、 A_6 、...、 A_9



输出: Y_0 、 Y_1 、...、 Y_{31} ;



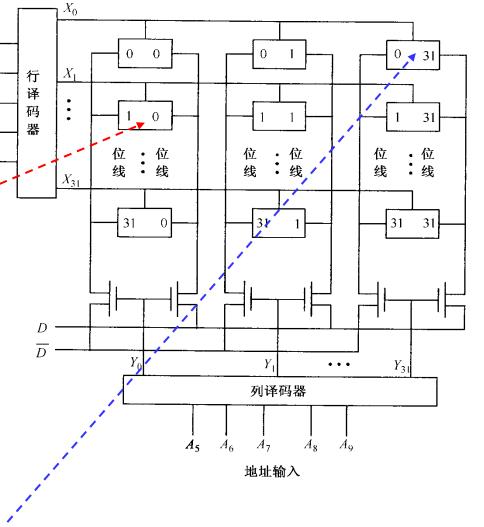
 $A_{9}A_{8}A_{7}A_{6}A_{5} A_{4}A_{3}A_{2}A_{1}A_{0}$ $= 00000 \ 00001$

行线 $X_1 = 1$. 列线 $Y_0 = 1$

地址:

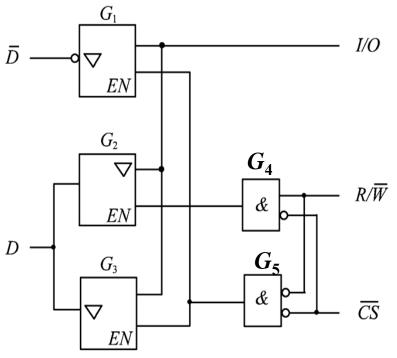
 $A_{9}A_{8}A_{7}A_{6}A_{5} A_{4}A_{3}A_{2}A_{1}A_{0}$ $= 11111 \ 00000$

行线 $X_0 = 1$ 、 列线 $Y_{31} = 1$



3. 输入/输出控制电路 (Input/Output)

1位数据输入/输出控制电路



Read/Write R/\overline{W} $\begin{cases} R/\overline{W} = 1 & \mathbf{读} \\ R/\overline{W} = 0 & \mathbf{写} \end{cases}$ 片选 \overline{CS} 低有效

输入/输出(I/O)端数据 线的条数=寄存器位数

容量 2k×16 RAM

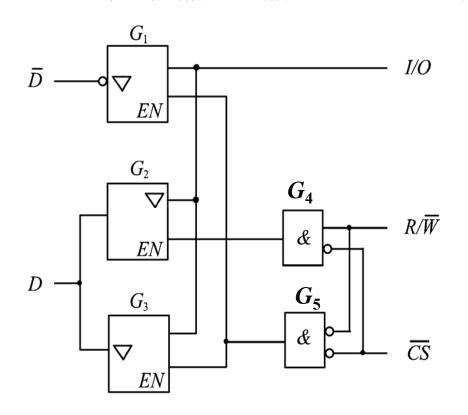
数据线 16条(位线)

D 和**D** 分别与存储矩阵 的两条位线相连。

 G_1 、 G_2 、 G_3 为三态门

当 \overline{CS} = 1时, G_4 、 G_5 输出为0,RAM芯片呈高阻态,输入I输出(I/O) 端与存储器内部完全隔离,不进行任何操作;

1位数据输入/输出控制电路



当 $\overline{CS} = 0$ 时,芯片被选通

若 $R/\overline{W} = 1$, $G_4=1$, G_2 导通, $G_5=0$, G_1 和 G_3 呈高阻态截止;

被选中的字的存储单元数据出现在输入/输出 I/O端,存储器执行读操作;

若 $R/\overline{W} = 0$, $G_5 = 1$, G_1 和 G_3 导通, $G_4 = 0$, G_2 呈高阻态截止;

此时 I/O 端数据以互补形式(\mathbf{D} , $\overline{\mathbf{D}}$)出现在内部数据线上,并被存入所选中的字的存储单元中,存储器执行写操作。

10.2.2 存储单元

器件分类 { Bipolar MOS

全国 6管 NMOS 静态存储单元 双极晶体管存储单元 4管 动态MOS 存储单元 1管 动态MOS存储单元

10.2.3 芯片简介

例 1. 16×2 RAM

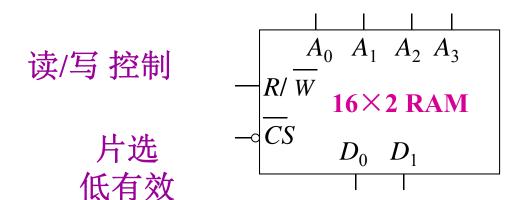
容量: 16×2 单元

字: $16 = 2^4$ 地址线: $4(A_3A_2A_1A_0)$

字长: 2-bit 数据线: $2(D_1D_0)$

地址

 A_3, D_1 高位



数据输入/输出

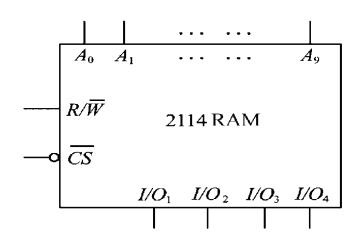
例 2. RAM2114

容量:

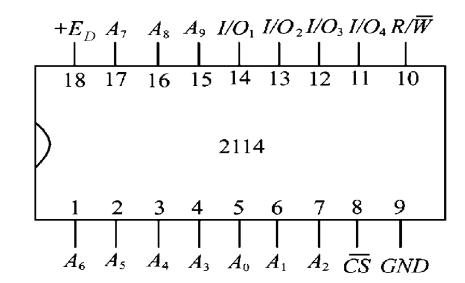
地址线: 10, $A_0 \sim A_9$,

1024 字 × 4 位 数据线 (输入/输出): 4, I/O₁~I/O₄

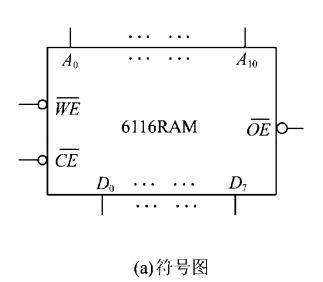
符号

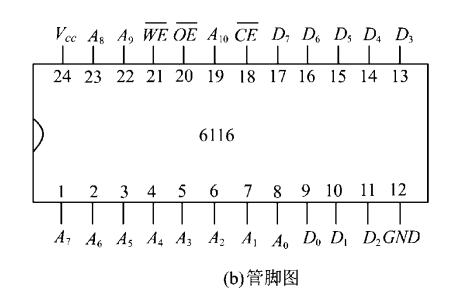


管脚图



例 3. RAM 6116





字: 地址线: 11 2¹¹ 字 (2k)

位: 8位

容量: 2¹¹ ×8 = 2k ×8 = 16k 单元 = 2k 字节

 \overline{CE} : 片选,低有效; \overline{OE} : 使能,低有效;

WE: 读/写 控制

10.2.4 RAM 扩展

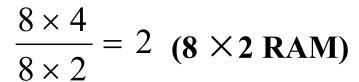
当芯片容量不足时,需要扩展.

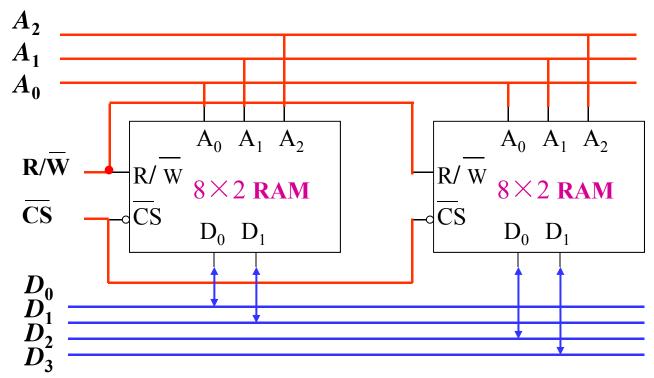
位扩展字扩展

1. 位扩展

方法: 同样的 RAM芯片 并联

例:将8×2 RAM 扩展成8×4 RAM





两片RAM 同时工作,地址范围不变,位(字长)扩展.

2-bit \rightarrow 4-bit

2. 字扩展

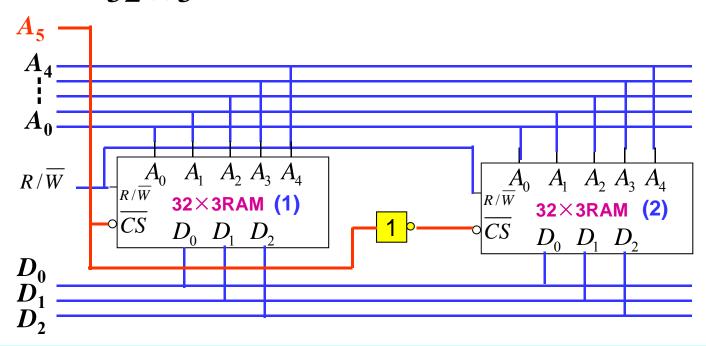
增加地址线

用 \overline{CS} 扩展字

 $_{R/W}$ 原地址线 $_{R/W}$ 数据线

例 1. 将 32×3 RAM 扩展成 64×3 RAM.

$$\frac{64 \times 3}{32 \times 3} = 2 (32 \times 3 \text{ RAM})$$
 地址线 5 → 6



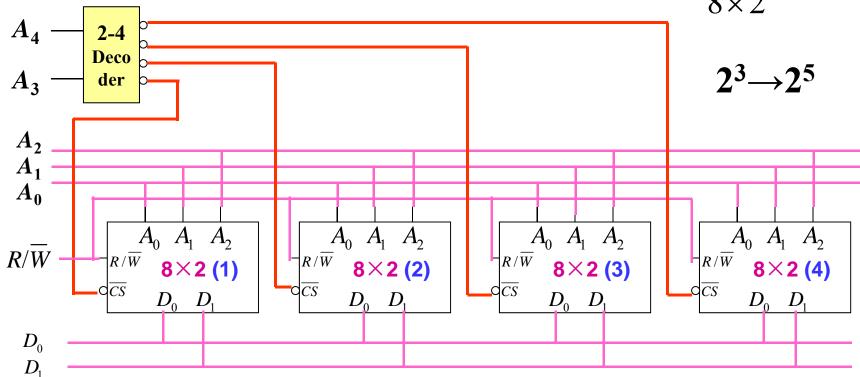
 A_5 =0 (1) 工作, (2) 停止; 地址 000000-011111

A₅=1 (1) 停止, (2) 工作; 地址 100000-111111

分射工作



$$\frac{32\times2}{8\times2}=4$$



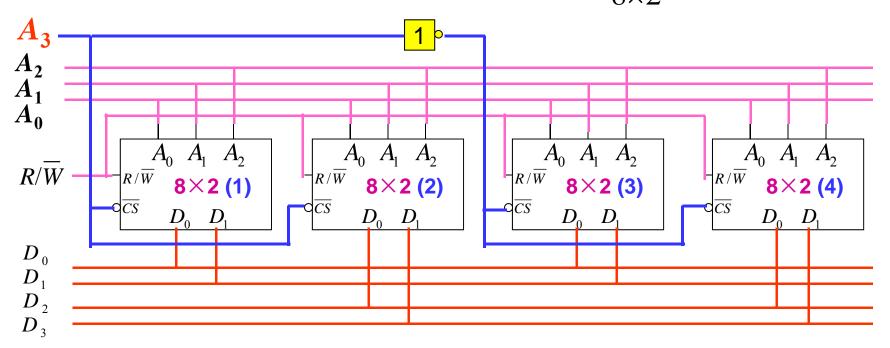
$$A_4A_3A_2A_1A_0$$

- **(1) 00**000**-00**111
- **(2) 01**000-**01**111
- **(3) 10000-10111**
- (4) **11**000-**11**111

3. 字位同时扩展

例 1. 将 8×2 RAM 扩展成 16×4 RAM.

$$\frac{16\times4}{8\times2} = 4(8\times2 \text{ RAM})$$



地址范围

(1)(2): 0000 - 0111 (3)(4): 1000 - 1111

十六进制表示法

16 进制: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 基数为 16.

存储器地址:

每4位二进制码表示一位十六进制码 后缀 H

例: 0000 1011 1111 ⇒ 0BFH

地址: B00H~BFFH =>>

 $A_{11}A_{10}A_{9}A_{8}A_{7}A_{6}A_{5}A_{4}A_{3}A_{2}A_{1}A_{0} \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$

§ 10.3 ROM (Read Only Memory)

ROM 是半导体存储器的一类。数据永久或半永久地存储在其中。可以从 ROM中"读出"数据,但没有"写"功能.

ROM一般由专用装置写入数据,数据一旦写入便不能随意改写,断电后,数据也不会丢失。

ROM:组合逻辑电路

10.3.1 ROM 分类

ROM 固定ROM (Mask ROM) 可编程ROM (Programmable ROM)

PROM (一次可编程ROM)

PROM

EPROM (Erasable PROM 可擦除可编程)

EEPROM (Electrically Erasable PROM 电可擦除可编程)

Flash Memory (快闪存储器)

类似于E²ROM,容量大

10.3.2 ROM 结构

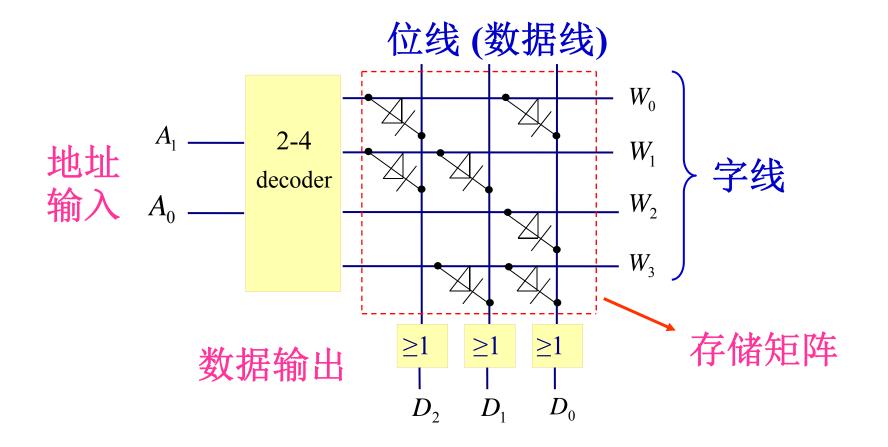
1. ROM (Mask ROM):

在生产过程中,数据被永久地储存在存储器内。 广泛用于标准函数

ROM 的结构与 RAM类似.

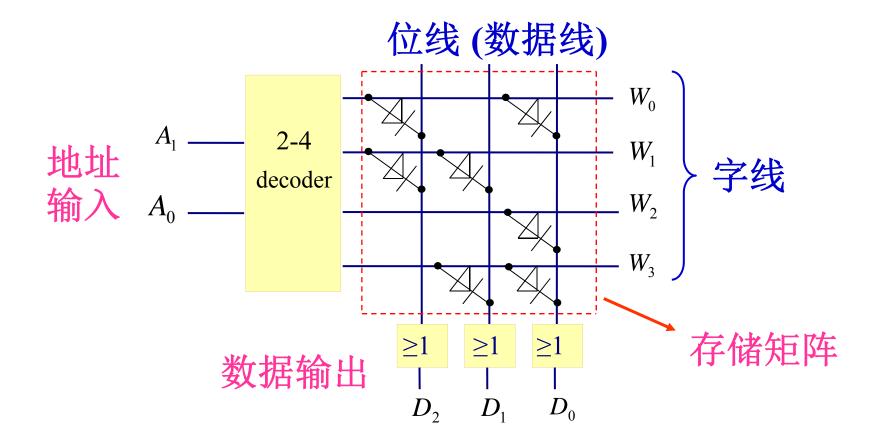
地址译码器:与门阵列

n -bit 地址码输入, 2^n 字线输出



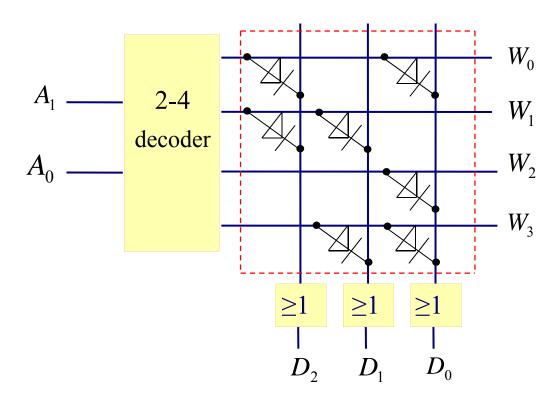
地址译码器: 把n 条地址线译成 2^n 条字线 $W_0 \sim W_3$ 。译码器 高电平有效

一组地址只能使一条字线高电平,使二极管导通。



存储矩阵 二极管,晶体管,MOSFET 连接字线和数据线.

输出缓冲 或门,3位 $(D_2D_1D_0)$



当 A_1A_0 =00, W_0 =1, 二极管导通, 输出 $D_2D_1D_0$ =101

$$D_2 = \overline{A}_1 \overline{A}_0 + \overline{A}_1 A_0 = \overline{A}_1$$

ROM 实现:

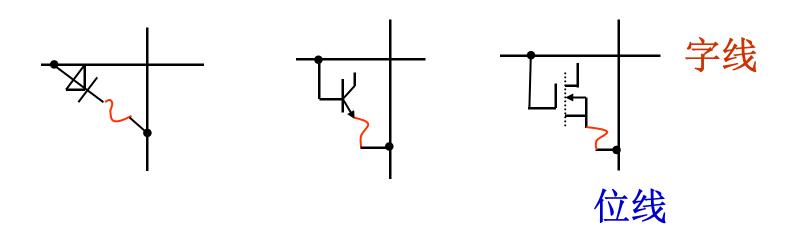
$$D_{1} = \overline{A}_{1} A_{0} + A_{1} A_{0} = A_{0}$$

$$D_{0} = \overline{A}_{1} \overline{A}_{0} + A_{1} \overline{A}_{0} + A_{1} A_{0} = \overline{A}_{0} + A_{1}$$

ROM实现的是标准与或式

2. PROM (一次可编程ROM):

每个存储单元 { Diode or transistor or MOSFET 熔丝



连接1,熔断0: 出厂时全连(1),用户根据需要将需要存入0的单元上的熔丝熔断

PROM一旦进行了编程,就不能再修改了。

10.3.3 ROM 应用

存储器 (ROM 主要功能), 也可以实现标准与或式逻辑功能

1. ROM 实现组合连接功能

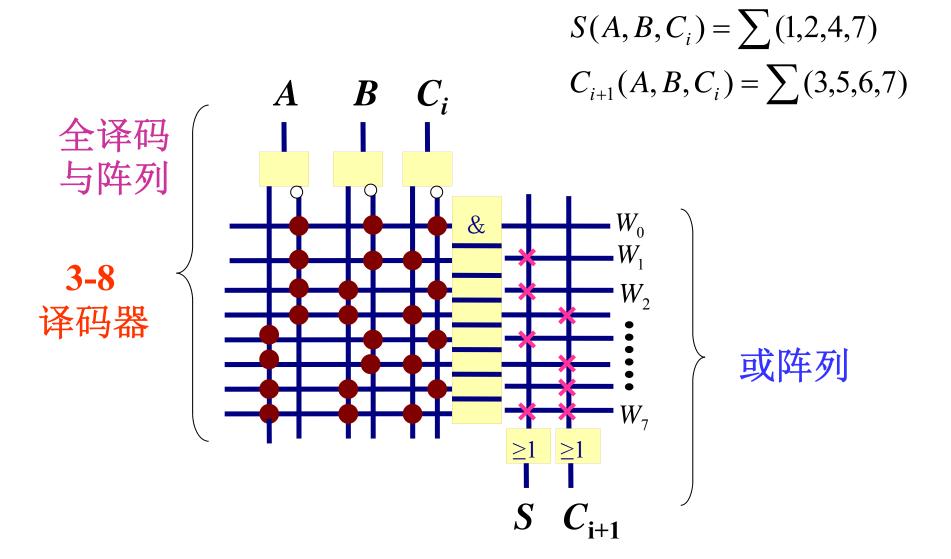
例:用ROM实现全加器

解:

全加器真值表

ROM 与译码器相同, 只能实现与或标准式

A	В	C_{i}	S	S C _{i+1}				
0	0	0	0	0				
0	0	1	1	0				
0	1	0	1	0				
0	1	1	0	1				
1	0	0	1	0				
1	0	1	0	1				
1	1	0	0	1				
1	1	1	1	1				



2. 用于函数运算表电路

例:用ROM构成能实现函数 $y = x^2$ 的运算表电路, x 的取值范围为 $0 \sim 15$ 的正整数。

解: (1) 分析

变量x:0~15正整数,

 \rightarrow 4 位二进制数 $x = X_3 X_2 X_1 X_0$

函数 $y=x^2$,

y的最大值: $15^2 = 225$,

 \rightarrow 8 位二进制数 $y = Y_7Y_6Y_5Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$

(2) 真值表

<i>X</i> ₃	X_2	Ж	Ж	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	十進制數
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	9
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	25
0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	36
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	49
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	64
1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	81
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	100
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	121
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	144
1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	169
1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	196
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	225

(3) 写标准与或表达式

$$Y_7 = m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15}$$

$$Y_6 = m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{14} + m_{15}$$

$$Y_5 = m_6 + m_7 + m_{10} + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$

$$Y_4 = m_4 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{12}$$

$$Y_3 = m_3 + m_5 + m_{11} + m_{13}$$

$$Y_2 = m_2 + m_6 + m_{10} + m_{14}$$

$$Y_1 = 0$$

$$Y_0 = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$

(4) 画ROM存储矩阵节点连接图

